

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司關於華虹半導體有限公司2024年半年度持續督導跟蹤報告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

葉峻

孫國棟

周利民

熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

关于华虹半导体有限公司

2024年半年度持续督导跟踪报告

重大事项提示

2024年上半年，华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）营业收入673,215.88万元，较上年同期下降23.88%；归属于上市公司股东的净利润26,491.63万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,384.86万元，分别较上年同期下降83.33%、83.46%。

受行业周期等影响，公司晶圆代工的平均销售价格下降、制造费用上升、研发工程片开支增加，使得营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均有所下降。2024年上半年，公司生产经营正常，不存在重大风险。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称“联席保荐人”）作为华虹公司持续督导工作的联席保荐人，负责华虹公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

工作内容	持续督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	联席保荐人已建立健全并有效执行持续督导制度，已根据华虹公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	联席保荐人已与华虹公司签订持续督导协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2024年上半年度，联席保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解华虹公司经营情况，对华虹公司开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体	2024年上半年度，华虹公司未发生按有关规定须联席保荐人公开发表声明的违法违规事项。

上公告。	
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或财务顾问应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，华虹公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	联席保荐人持续督促、指导华虹公司及其董事、高级管理人员，2024 年上半年度，华虹公司及其董事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	联席保荐人督促华虹公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了华虹公司内控制度建立与执行情况，华虹公司内控制度符合相关法规要求，2024 年上半年度，华虹公司有效执行了相关内控制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	联席保荐人督促华虹公司依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	联席保荐人对华虹公司的信息披露文件进行了审阅，不存在因信息披露文件出现问题应向上海证券交易所报告的情况。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024 年上半年度，华虹公司及相关主体不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，华虹公司及相关主体不存在未履行承诺的情况。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，华虹公司未出现该等事项。
14、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司	2024 年上半年度，华虹公司及相关

<p>做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>主体未出现该等情况。</p>
<p>15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>2024年上半年度，华虹公司不存在需要专项现场检查的情形。</p>

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年上半年度，联席保荐人和保荐代表人未发现华虹公司存在需要进行整改的重大问题。

三、重大风险事项

华虹公司面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、未能紧跟工艺节点、工艺平台等技术迭代的风险

半导体行业是资本、人才及技术密集性行业，从晶圆制造工艺到下游产品需求等技术更新的迭代速度较快。公司以先进特色工艺领域作为自身战略发展方向，包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。随着汽车电子、工业控制、新能源等领域的快速发展和市场需求，如嵌入式/独立式存储平台中的MCU产品、逻辑及射频平台中的逻辑类产品均已出现向更先进工艺节点的拓展需求，而电源管理平台中应用的BCD工艺以及IGBT等功率器件领域亦已出现向更高电压水平等性能拓展的技术需求，公司需不断结合代工产品及市场需求，升级自身的技术水平和研发能力，以保持足够的技术竞争力。

未来，如果受到硬件限制、研发投入不足或技术人才流失等影响，公司可能无法在相关技术及工艺领域紧跟技术迭代，亦或大量研发投入未能获得理想效果及适应需求变化，则可能难以保持其在相关市场的竞争地位，从而对公司后续长期技术发展、经营及财务状况产生不利影响。

2、技术人才流失或无法获得相应人才的风险

随着半导体行业技术的不断进步，对技术人才的专业性、经验要求和管理能力的要求也不断提升，已形成较高的技术门槛。同时，行业中的人才竞争及流动也日益激烈。公司一贯高度重视人才激励与培养，制定合理的人才政策及薪酬管理体系。如果公司的薪酬体系、激励措施和保护措施无法为自身吸引到相匹配的技术与管理人才，则可能面临人才的流失，从而影响公司的持续发展。

3、知识产权保护与技术泄密的风险

在半导体行业的发展与竞争中，相应的知识产权保护体系至关重要，也是获取竞争优势与长期发展的关键要素。公司制定了信息安全保护制度及各项保密措施，但由于技术保护措施存在一定的局限性，在人员流动、上下游业务交流的过程中，公司的技术和研发成果仍面临一定的泄密风险，从而对公司在技术方面的竞争优势产生不利影响。

(二) 经营风险

1、研发与生产持续巨额资金投入风险

晶圆代工行业属于资本密集型行业，需不断优化升级现有工艺技术平台以及创新研发项目投入，以保持市场竞争优势，并保证充足的产能以满足订单生产需求，提高核心竞争力，公司需要持续进行巨额的资金投入。未来，如果公司不能获取足够的经营收益，或者融资受限，导致资金投入减少，可能对公司的竞争优势产生不利影响。

2、供应链风险

半导体行业依赖于特定原材料、各种关键零备件和设备等，且合格供应商数量较少，部分供应商可能位于地缘政治不稳定的地区，若发生供应中断、短缺或价格波动，可能影响产品交付，对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

（三）财务风险

1、业绩波动风险

受手机等部分消费电子需求复苏，而汽车电子、新能源等终端市场仍处于库存调整期，2024年上半年整体需求呈不同表现。未来受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动，进而影响公司收入及盈利水平。如果公司未能及时应对上述市场变化，将面临业绩波动的风险。

2、主营业务毛利率波动风险

如果半导体行业景气度下降、行业竞争加剧、原材料采购价格上涨，则可能导致公司产品单价的下降或单位成本的上升，主营业务毛利率存在下降的风险。

3、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，国际贸易局势的变化、金融政策的调整等均会对其造成影响。公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，但公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率产生的影响程度，因此，人民币汇率的波动可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

4、依赖境内运营子公司股利分配的风险

公司的资金需求包括向公司股东支付股利及其他现金分配、支付公司在中国境外可能发生的任何债务本息，以及支付公司的相关运营成本与费用。公司是一家控股型公司，实际生产运营实体位于中国境内，境内运营子公司向公司进行股利分配是满足公司的资金需求的重要方式之一。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，中国公司必须在弥补亏损和提取法定公积金后方可向股东分配税后利润，故如果境内运营子公司存在未弥补亏损，则无法向上层股东进行股利分配。此外，即使在境内运营子公司根据中国法律、法规和规范性文件规定存在可分配利润的情况下，公司从境内运营子公司获得股利分配还可能受到中国外汇相关法律、法规或监管政策的限制，从而导致该等境内运营子公司无法向公司分配股利。

如发生上述境内运营子公司无法分配股利情况，则公司的资金需求可能无法得到满足，进而影响公司向债权人的债务偿还，以及其他运营成本与费用的正常开支，对公司的持续经营产生不利影响，公司向投资人分配股利的能力也将受到较大负面影响。

5、税收优惠政策风险

公司子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司具备高新技术企业资格，自2023年度至2025年度享受企业所得税优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。未来，如果上述税收优惠政策发生变化或者上述子公司不再符合相关资质，将对公司未来的所得税费用产生不利影响。

（四）管理风险

公司生产经营规模不断扩大，资产规模、员工人数持续增长，随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模和人员规模也将进一步增长，对公司组织管理制度及管理体系提出更高的要求。因此，如果公司管理水平不能适应经营规模扩张的需要，管理制度及管理体系未能及时调整和完善，公司将面临较大的管理风险。

（五）行业风险

1、宏观经济波动和行业周期性的风险

受到全球宏观经济的波动、行业景气度、产能周期性等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关。同时，半导体行业晶圆制造环节的产能扩充呈现周期性变化特征，通常下游需求变化速度较快，而上游产能的增减则需要更长的时间。因此，半导体行业供应端产能增长无法完美匹配半导体行业需求端的变化，导致行业会出现供需关系周期性的变化，也会带来行业价格和利润率的变化。此外，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电子等下游市场需求的波动和低迷亦会导致半导体产品的需求下降，可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、市场竞争加剧的风险

根据SEMI（国际半导体产业协会）发布的《世界晶圆厂预测报告》，为跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在

2025年实现7%的增长，中国芯片制造商也在继续积极投资扩产，预计在2024年增长15%，2025年将增长14%。现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。

目前，公司产品的主要市场领域包括新能源汽车、工业智造、通讯、物联网、消费电子等。如果公司不能准确把握行业发展规律、持续研发创新、改善经营管理，可能导致竞争优势下降，对公司的盈利能力造成不利影响。

3、国际贸易摩擦的风险

公司使用的主要生产设备和原材料有较大部分向境外供应商采购。公司坚持国际化运营，自觉遵守国际间有关出口管制的原则，自成立以来始终合规运营，依法开展生产经营活动。但未来不排除相关国家出口管制政策进行调整的可能，从而导致公司面临设备、原材料供应发生变动等风险，导致公司生产受到一定的限制，进而对公司的业务和经营产生不利影响。

4、产业政策变化风险

半导体产业是我国的战略支柱产业，近年来国家层面出台一系列支持政策。在产业政策支持和国民经济发展的推动下，我国半导体行业整体的设计能力、生产工艺、自主创新能力有了较大的提升。如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司的业务发展、人才引进、生产经营产生一定不利影响。

（六）法律风险

1、公司现行的治理结构与中国境内设立的A股上市公司存在差异的风险

公司为一家根据香港《公司条例》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。公司的公司治理制度需遵守香港《公司条例》和《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）组织章程细则》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般境内A股上市公司的公司治理模式在利润分配机制、重大事项决策程序、剩余财产分配等方面存在一定差异。

2、公司注册地、上市地和生产经营地所在司法管辖区的合规与监管风险

公司注册地、上市地和生产经营地所在司法管辖区的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、更新法律法规或规范性文件，公司于美国、日本、开曼群岛、中国内地及香港地区均设有子公司，需要同时接受境内外监管机构的监督与管理，遵守各相关司法管辖区的适用法律法规。如被监管机构认定为未能完全遵守相关规定，则公司可能面临被处罚或被采取监管措施，从而可能引致业务发展和经营业绩的不利影响。

3、安全生产的风险

公司生产所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。公司未来如果生产设备出现故障，或者危险材料和设备使用不当，可能导致火灾、爆炸、危险物泄漏等意外事故，将面临员工伤亡、财产损失、甚至产线停工等风险，并可能造成客户流失或受到相关部门的行政处罚，将对公司的生产经营产生不利影响。

4、诉讼仲裁风险

公司所处的晶圆代工行业是带动半导体产业联动的关键环节，且公司经营规模较大，客户、供应商数量众多。在未来的业务发展过程中，公司不能排除因知识产权、合同履行等事项，与客户、供应商或其他第三方发生诉讼或仲裁，从而耗费公司的人力、物力以及分散管理精力，并承担败诉后果的风险，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

四、重大违规事项

2024年上半年度，华虹公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，华虹公司主要会计数据如下所示：

单位：人民币万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	增减变动幅度（%）
营业收入	673,215.88	884,395.39	-23.88
归属于上市公司股东的净利润	26,491.63	158,871.85	-83.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,384.86	141,413.59	-83.46

经营活动产生的现金流量净额	132,890.90	224,182.62	-40.72
主要会计数据	2024年6月末	2023年6月末	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,339,767.66	4,335,425.24	0.10
总资产	8,498,619.06	7,622,635.11	11.49

2024年上半年，华虹公司主要财务指标如下所示：

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	1.21	-87.60
稀释每股收益(元/股)	0.15	1.20	-87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	1.08	-87.04
加权平均净资产收益率(%)	0.61	7.72	减少7.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	6.87	减少6.33个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.50	7.59	增加3.91个百分点

上述主要会计数据和财务指标的变动原因如下：

本报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系晶圆代工的平均销售价格下降、制造费用上升、研发工程片开支增加所致。

综上，公司2024年上半年主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是国际领先也是中国大陆最大的特色工艺晶圆代工企业，依托完善的研发体系以及长期的工艺经验及专利积累，在嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频领域形成了极具竞争力的特色工艺平台。

针对半导体产品种类众多，需求多样的特点，特色工艺不追求沿摩尔定律规则不断追求晶体管缩小，而是通过持续优化器件结构与制造工艺，最大化发挥不同器件的物理特性以提升产品性能及可靠性。公司在上述五大特色工艺平台领域建立了丰富多元化的代工产品结构，以满足下游消费电子、汽车电子、

工业控制、计算机与通讯，以及诸多新兴领域如新能源、服务器等不断迭代的产品需求。

报告期内，公司持续加大研发投入和提升专利储备数量来巩固核心竞争力，在研发人员数量、整体研发投入金额、累计获授权专利数量等方面继续保持增长。

在工艺平台方面，公司继续推进嵌入式/独立式非易失性存储器在全新工艺节点上的研发，通过自主技术创新研发的NORD-Flash单元以及相关低功耗、超低漏电工艺不断迭代闪存工艺平台，满足市场上MCU等产品对超低静态功耗与芯片性能的双重需求，为客户在消费电子、汽车电子、工业控制、智慧医疗及物联网等领域提供高良率的优质芯片制造平台。在模拟与电源管理平台，公司继续推进65/90纳米BCD工艺的持续优化与量产，为部分下游新兴消费领域的强劲需求提供可靠优质的工艺生产能力。除此以外，在功率器件领域，虽然市场需求尚待复苏，公司仍持续迭代自主研发的新一代IGBT与超级结MOSFET工艺，使其器件在大电流、高电压、尺寸体积、可靠性等综合性能方面更具优势，也为国内新能源、汽车电子等领域未来的持续进步提供优质保障。

同时，作为一家晶圆代工企业，充足的产能规模及良好的产能利用水平也是保持企业竞争优势的关键。公司坚持“8英寸+12英寸”的发展战略，报告期内加快无锡新12英寸产线的建设，以期在2025年实现规模量产，带动公司产能与产品组合的竞争优势提升。另一方面，面对过去数个季度半导体整体市场的需求波动及缓慢复苏态势，公司高度重视产能利用率及运营效率的提升和改善，报告期内，公司产能利用率已逐步从相对低谷回升至接近满产的水平，在行业下行周期中，公司产能利用率持续保持在全球晶圆代工同行业企业中的领先水平。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024年上半年，公司研发费用为77,126.65万元，较上年同期增长14.94%。2024年上半年，公司研发投入占营业收入的比例为11.50%，与上年同期增加3.91个百分点。

(二) 研发进展

公司以自身发展战略与竞争优势为依托，经过长期技术积累与工艺迭代，在主要工艺平台领域掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，并形成了公司现有的特色工艺核心技术平台。

报告期内，公司继续保持研发投入及累计获得授权专利的增长，各工艺平台均继续推进新一代特色工艺的优化进步。其中，嵌入式/独立式非易失性内存 (eNVM/Standalone NVM) 工艺平台将在全新工艺节点开展研发，实现芯片性能、功耗能效、应用领域的提升，带动MCU和智能卡芯片等重点产品销量和应用领域的不断成长。40纳米特色工艺平台开始小规模试生产，产品种类持续丰富。65/90纳米BCD平台业务发展顺利，终端需求旺盛，上半年出货量大幅增长。功率器件方面推进新一代IGBT与超级结MOSFET工艺技术优化，静待市场需求复苏。

2024年上半年，多个平台项目开发按计划进行，详情请参阅下述在研项目情况。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	40纳米特色工艺	平台工艺器件可靠性考核通过，高密度SRAM TQV良率符合要求，平台已导入多颗新产品。平台持续上量中。多个衍生平台按计划开发中。	在标准平台基础上，进一步开发衍生平台，优化高密度SRAM性能，匹配市场多元化市场需求	中国大陆成熟工艺先进水平	主要应用于智能消费类电子和物联网应用。逐步向汽车电子类应用拓展。
2	40纳米嵌入式闪存	器件调试完成，已启动工艺可靠性考核。	完成平台开发。完成闪存和SRAM性能、可靠性，满足车规级需求。	中国大陆先进水平	主要应用于汽车电子，工业控制，及消费电子领域
3	新一代独立式闪存（4X NOR FLASH）	多颗产品开启风险量产。	未来将继续针对大容量、低功耗产品需求持续优化。	存储单元较目前成熟量产工艺进一步缩小20%	应用在消费，工业和汽车，需要大容量存储的智能化产品
4	90纳米BCD	40V以下新一代平台工艺定型，Rsp等关键性能提升30%，模型和PDK 0.1版设	新一代技术平台将进一步提升功率器件优值，和安全工作区。同时开发与闪存集	高压器件优值业界领先	平台提供模拟，信号链，电源管理芯片，用于消费，工业和汽车等应用领域。

		计环境完成。60V 和 80V 通过可靠性考核，开始提取模型。	成的平台，满足车规级需求。		
5	新一代功率器件	650V平台已固化，一款产品进入量产，三款进入风险量产阶段。1200V平台完成Alpha客户评估，三款产品进入小批量试产。	完成平台开发，并逐步开发更高电压，更大电流的技术平台，进一步拓展高压大电流场景应用。	公司特有技术	主要用于光伏逆变，xEV牵引逆变，EV充电桩，车载充电机，储能逆变器

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减：支付发行费用	1,226.97
减：募投项目累计支出金额	433,152.37
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,768.01
期末募集资金专户余额	1,675,630.06

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致，下同。

截至2024年6月30日，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	存款方式	金额（人民币万元）
招商银行股份有限公司上海分行	NRA999017055210902	活期存款及协定存款	306,413.98
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款及协定存款	7,613.86
国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款及协定存款	1,916.49
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款	190,252.10
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款	208,367.82

中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999998	活期存款	2.80
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款	319,677.30
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600013001312349	活期存款	298,984.62
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款	144,703.70
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款	197,697.38
合计			1,675,630.06

公司2024年上半年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。截至2024年6月30日，华虹公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司间接控股股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，通过集中竞价的方式增持公司股份，2024年上半年度增持公司A股股份数合计为158,774股。截至2024年6月30日，间接控股股东华虹集团及直接控股股东上海华虹国际公司（Shanghai Hua Hong International, Inc.）合计持有公司348,804,167股股份。

截至2024年6月30日，公司董事、高级管理人员直接持有公司A股股份的情况未发生变动。

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在联席保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



寻国良



李 淳



（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



郭凯丞



刘勃延

